



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110426001
2011 年 4 月 29 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Philippines 製造 NFBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

日本での震災は、TI 美浦工場（茨城県、東京の北東 40 マイル(64km)）被害に加えて、弊社 IC パッケージ供給チャンネルにも一部影響を与えました。TI は一日も早い供給フローの正常化に向け、他供給業者からの支援の下懸命に作業しております。

今回のお知らせは、BGA パッケージ Substrate 代替部材追加についての連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為にも、本通知記載の対象製品について追加部材の認定を迅速に実施してまいります。

TI は現行最善の情報及び知識に基づき本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、再度変更追加があった場合には、本通知の更新にて連絡させていただきます。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21 日**以内に本通知受領のご確認をお願いいたします。TI は、供給遅延を最小限にとどめるために、5 月の出荷が開始されるべく追加部材認定を実施する予定です。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	TI-Philippines 製造 NFBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加 現行 ： 認定 Substrate 変更後： 認定 Substrate, Sumitomo 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5 月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: TI-Philippines(フィリピン)サイト製造 NFBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

Substrate 部材

現行

認定 Substrate

変更後

認定 Substrate
Sumitomo 社製 Substrate

理由: 供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
AM1802BZWD3	OMAPL138BZWD4	TMS320DA260ZWF	TMS320DM365ZCEF	TMS320DM6446BZWT7
AM1806BZWT3	PTPS65930BZCH	TMS320DM320ZVL	TMS320DM368ZCE	TMS320DM6446BZWT A
AM1808BZCEA3	PTWL5030AZXN	TMS320DM320ZVLR	TMS320DM368ZCED	TMS320DM6446BZWT
AM1808BZWT3	SN200507002ZZCR	TMS320DM335ZCE135	TMS320DM6431ZWTQ3	TMS320VC5504MZCH
AM1808BZWT4	SN74CBTU4411ZSTR	TMS320DM340ZVL	TMS320DM6433ZWT4	TMS320VC5504XZCH
AM3505AZCN	TLV320A1C341ZASR	TMS320DM345ZVL	TMS320DM6433ZWT6	TMS320VC5505MZCH
AM3505AZCNA	TMS320C5504AZCH10	TMS320DM350HZWK	TMS320DM6435ZWT6	TMS320VC5505ZCH
AM3505ZCN	TMS320C5504AZCHA10	TMS320DM350LZWK	TMS320DM6435ZWTQ6	TPS65920BZCH
AM3517AZCN	TMS320C5505AZCH12	TMS320DM350UHZWK	TMS320DM6437ZWT5	TPS65930BZCH
AM3517AZCNA	TMS320C5505AZCH15	TMS320DM355CZCE216	TMS320DM6437ZWT6	TPS65930BZCHR
DM355SZCE270	TMS320C5505AZCHA10	TMS320DM355DZCE270	TMS320DM6437ZWT7	TPS65950A2ZXNR
DM6446ANB6C2127VC	TMS320C6421ZWT6	TMS320DM355DZCEA21	TMS320DM6437ZWTQ4	TPS65950A3ZXN
DM644NECED1C2102VC	TMS320C6421ZWTQ5	TMS320DM355ZCE135	TMS320DM6437ZWTQ5	TPS65950BZXN
F761541AZVLR	TMS320C6424ZWT4	TMS320DM355ZCE216	TMS320DM6437ZWTQ6	TPS65950BZXNR
OMAPL138AZCE3	TMS320C6424ZWT6	TMS320DM355ZCE270	TMS320DM6441AZWT	TUSB1310AZAY
OMAPL138AZCEA3	TMS320C6424ZWT7	TMS320DM355ZCEA135	TMS320DM6441BZWT	TUSB1310ZAY
OMAPL138AZWTA3	TMS320C6424ZWTQ5	TMS320DM355ZCEA216	TMS320DM6443AZWT	TWL4030C1ZXN
OMAPL138BZCEA3	TMS320C6746AZWT3	TMS320DM357ZWT	TMS320DM6443AZWTB	TWL5030A2ZXN
OMAPL138BZCEA3D	TMS320C6746BZCE3	TMS320DM365ZCE21	TMS320DM6443ZWT	TWL5030BZXN
OMAPL138BZWT3	TMS320C6746BZWT3	TMS320DM365ZCE27	TMS320DM6446AZWT	TWL5034A2ZXN
OMAPL138BZWTA3	TMS320C6748AZWT3	TMS320DM365ZCE30	TMS320DM6446AZWTA	TWL5034A2ZXNR
OMAPL138BZWTA3R	TMS320C6748BZWT3	TMS320DM365ZCED30	TMS320DM6446BZWT	TWL92233AZZB

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	AM3517ZCN	Substrate:	Sumitomo Substrate	
Package:	NFBGA	Site(s):	PHI	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Material Property Comparison	Specification Review		per spec	
Preconditioning	JEDEC L-4/260C		539	
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)		45	
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc		231	
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)		77	
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs		231	
Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs				